

会社概要 (2024年12月31日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. FPD関連装置 3. レーザー顕微鏡
従業員数	連結 1,079名 単体 497名
お問い合わせ先	045-478-7127 (企画管理部)

株式情報 (2024年12月31日現在)

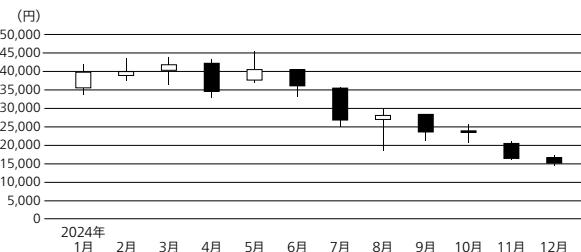
株式概要

上場市場	東京証券取引所プライム市場
発行済株式総数	94,286,400株
株主数	92,270名
大株主一覧	

	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	17,898	19.84
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	7,043	7.80
内山 洋	2,813	3.11
内山 秀	2,788	3.09
前田 せつ子	2,734	3.03
STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234	1,612	1.78
株式会社三菱UFJ銀行	1,504	1.66
UCHIYAMA HOLDINGS株式会社	1,477	1.63
高橋 はる香	1,440	1.59
楽天証券株式会社	1,047	1.16

(注) 1. 当社は、自己株式を4,096千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株価の推移



取締役および監査役

代表取締役 社長執行役員 仙洞田 哲也	取締役 会長執行役員 岡林 理	取締役 副会長執行役員 楠瀬 治彦	取締役 常務執行役員 田島 敦
取締役(社外) 三原 康司 岩田 宜子 石黒 美幸 由利 孝	常勤監査役 浅野 政克	監査役 浅見 公一	監査役(社外) 出雲 栄一 道 あゆみ

株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)
単元株式数	100株
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
特別口座管理機関	(同上)
同連絡先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(通話料無料) 郵送先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。



(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三井住友信託銀行)にお問い合わせください。なお、三井住友信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行の本支店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内

<https://www.lasertec.co.jp/ir/>

日興アイ・アール株式会社の「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」にて総合部門最優秀サイトに選ばれました。



▼ Gomez / IRサイト総合ランキング銅賞(2024年)



UD FONT

株主通信

Lasertec News 32

証券コード 6920

第63期
中間期

2024年7月1日▶
2024年12月31日

Inventing for your success,
inventing for the future

Lasertec



市況変化に対応し、 持続的な成長を

代表取締役
社長執行役員 仙洞田 哲也

中間期の業績報告

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当中間連結会計期間における世界経済は、地政学リスクや政策動向による景気減速が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続きました。
当社グループの主要販売先である半導体業界においても、スマートフォンやパソコンを中心とした最終需要の回復が鈍く、デバイスメーカーの先端半導体を含め

た投資計画の一部で見直しが行われました。特定の分野においては、生成AI関連への投資が活発に行われた一方で、パワー半導体関連への投資は低調に推移しました。
当中間連結会計期間の売上高は1,289億68百万円(前年同期比35.8%増)となりました。品目別では、半導体関連装置が1,030億81百万円(同27.1%増)、その他

が37億11百万円(同304.4%増)、サービスが221億75百万円(同70.6%増)となりました。連結損益につきましては、営業利益が636億62百万円(同100.5%増)、経常利益が624億38百万円(同99.5%増)、親会社株主に帰属する中間純利益が433億18百万円(同95.1%増)となりました。

中期経営計画

このたび、2030年6月期を最終年度とする中期経営計画の財務目標を発表いたしました。

生成AIをはじめ、IoT、5G/6Gやデータセンターなど、半導体が使われる分野はさまざまな用途に広がっており、現在5,000億米ドルほどの半導体市場は、2030年には1兆米ドルを超える規模にまで成長すると予想されています。

レーザーテックはこの市場成長を上回る年平均成長率10%以上を目指し、2030年6月期を最終年度とする中期経営計画の財務目標として、売上高4,000~5,000億円、営業利益率35%以上と設定いたしました。

中間配当

中間配当額は前期中間配当より42円増配の1株当たり115円といたします。

期末配当額は前期比16円増配の173円を予定しており、年間では288円(前期比58円の増配)となる見込みです。

株価対策に対する考え方

当社は、お客さまのご期待・ご要望にお応えし続けることで、業績を持続的に成長させることが何よりの株価対策であると考えております。

売上最大化とさらなる成長へ向けて、中期経営計画で策定した各施策を着実に実行してまいります。なお、中期経営計画は進捗確認や見直しを毎年行い、事業機会を最大限に捉えるための追加的な施策を検討、実施いたします。

また「IR対応の強化」も重要な株価対策と捉えており、株式市場で適正な株価が形成されるよう、今後もIR活動を通じた情報開示を積極的に行ってまいります。

レーザーテックは、「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念として、当社の強みである光技術を生かしたビジネスを通じて世の中に貢献し、業績の向上につなげてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

業績ハイライト

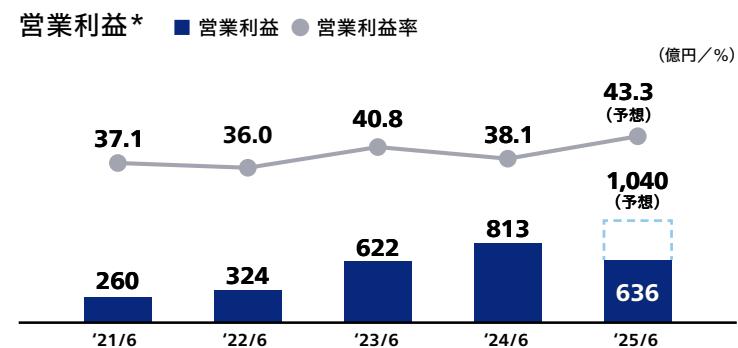
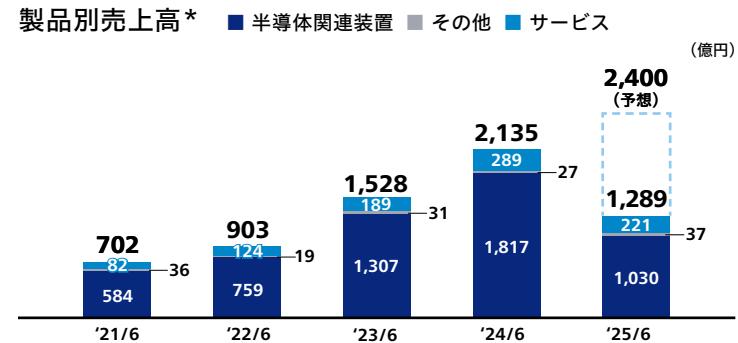
売上高 前年同期比 35.8% ↑
1,289億68百万円

営業利益 前年同期比 100.5% ↑
636億62百万円

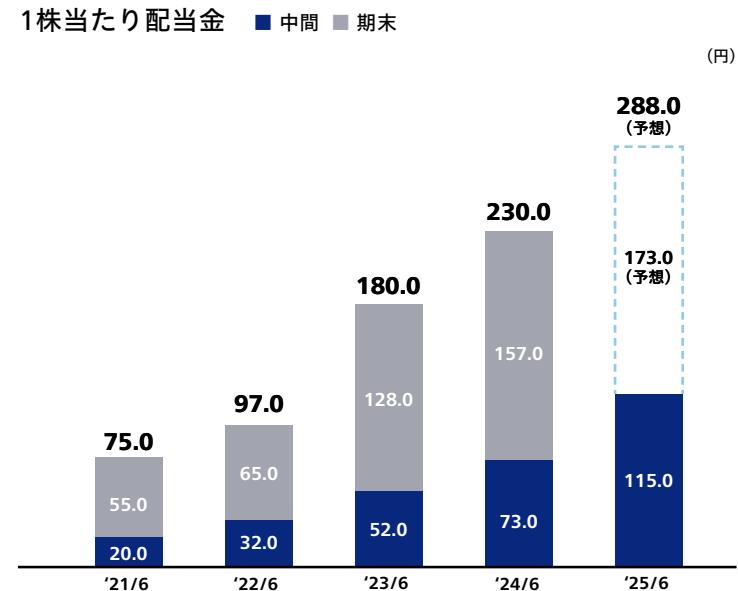
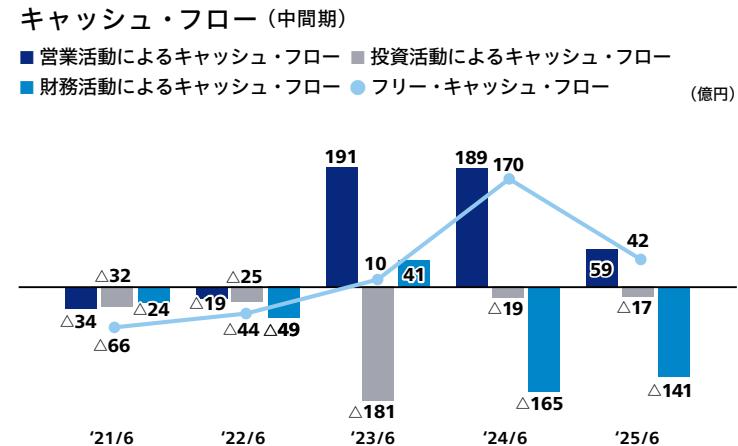
親会社株主に
 帰属する
 中間純利益 前年同期比 95.1% ↑
433億18百万円

自己資本 **1,797億80**百万円

資産合計 **2,883億47**百万円



* '24/6期までは通期の業績、'25/6期は中間期の業績です。



中間配当金

12月末日を基準日とする配当金は

1株当たり115.0円

とさせていただきます

前年同期 1株当たり73.0円

決算のポイント

純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は1,798億2百万円となりました。自己資本比率は62.3%で、引き続き財務の健全性を維持しています。

売上高/利益

半導体関連装置とサービスの売上高が上半期の過去最高となったことにより、全体の売上高および利益も上半期の過去最高を更新しました。

営業活動による キャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益、仕入債務の増加などの収入が、売上債権の増加、前受金の減少などの支出を上回りました。

2024年
9月24日
発表

SiCウェハ欠陥検査/レビュー装置 SICA108

SiC^{*1}ウェハの表面と内部の欠陥を高速に検出、高精度な分類まで同時に行えるSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置SICA108を製品化しました。SiCパワーデバイスは、電気自動車やエアコン、太陽光発電システム、鉄道車両などへの搭載が進み、脱炭素社会の実現に貢献しています。しかしながら、SiCウェハ製造プロセスの難易度が

高いために、製造工程において歩留りに影響を与える欠陥がまだ数多く存在し、高品質なウェハの安定的な量産と生産コストの低減が課題となっています。このような課題の解決に貢献すべくSICA108は従来機のスループット^{*2}のさらなる高速化、品質把握とコストオペナーシップの改善を実現しました。



*1 SiC:シリコン (Si) と炭素 (C) で構成されるパワー半導体の材料。高温や高電圧に耐える特性があり、効率的な電力変換が可能
*2 スループット:一定時間当たりに処理できる量

2024年
12月2日
発表

EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICSシリーズE320

次世代EUVマスクブランクの欠陥管理と歩留まり向上に貢献するEUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICSシリーズE320を製品化しました。従来機ABICSシリーズE120は、EUVマスクブランクの欠陥に対する高い検出感度と欠陥座標精度により、お客さまから高い評価と信頼を得ています。一方、半導体デバイスのさらなる微細

化に向けたHigh NA EUVリソグラフィ^{*3}実用化のための技術検討が進捗しており、EUVマスクブランクのより微小な位相欠陥の管理が必要となっています。新製品ABICSシリーズE320は、新たに設計した光学系を用いることで、High NA EUVリソグラフィ世代に必要な欠陥検出感度と欠陥座標精度を実現しました。



*3 High NA EUVリソグラフィ:半導体製造における次世代の露光技術。より微細なパターンを形成することが可能で、半導体製造の効率と精度が大幅に向上する

2024年
12月2日
発表

EUVペリクル異物検査装置 PELMISシリーズ

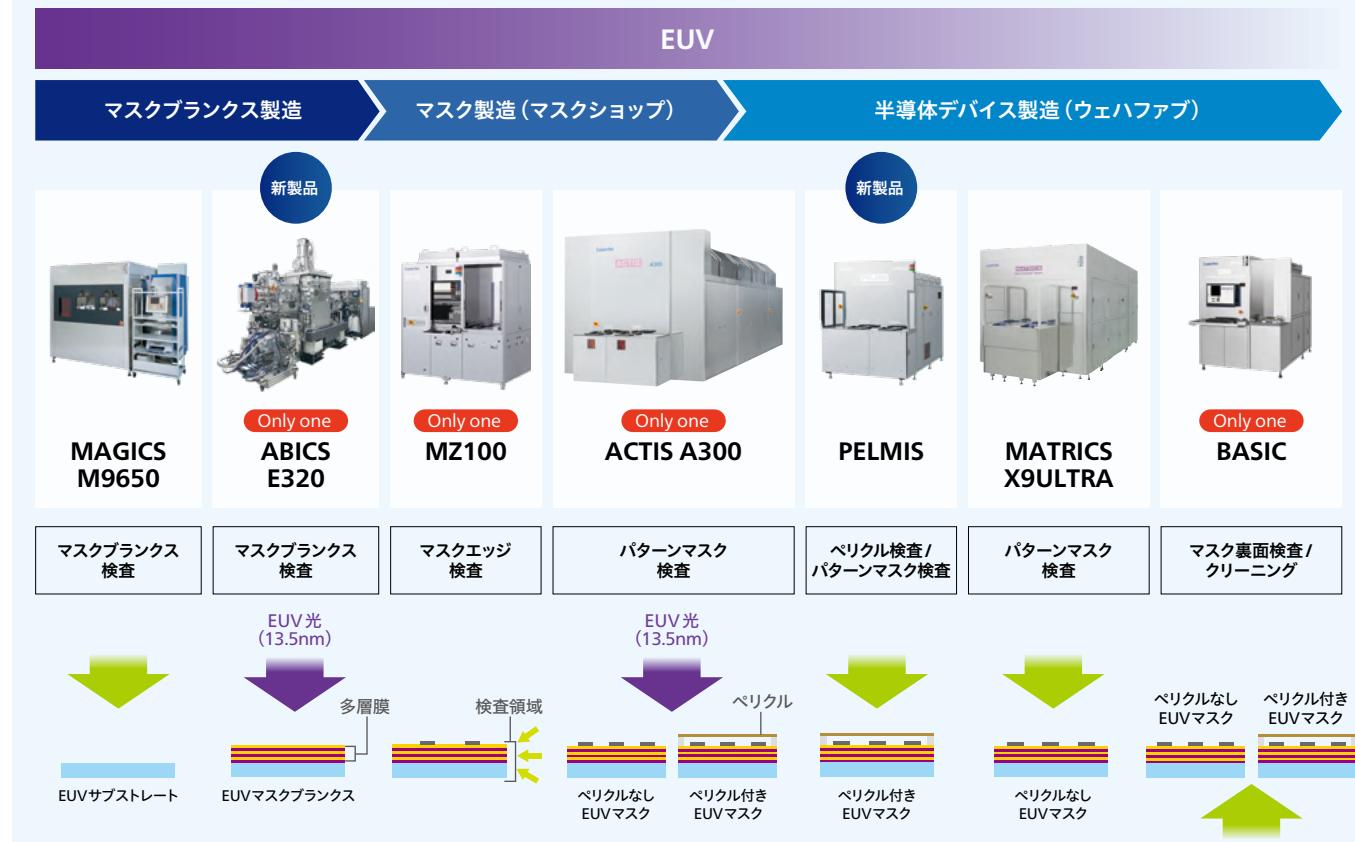
EUVペリクル^{*4}付きマスクの検査工程において生産性の向上に貢献するEUVペリクル異物検査装置PELMISシリーズを製品化しました。近年EUV市場の拡大に伴い、EUVペリクルの検査需要が高まっています。PELMISシリーズは、EUVペリクル付きマスクのペリクル面の異物検査と付着異物の表裏自動

分類を実現し、パターン面およびパターン外周部の異物検査にも対応した装置です。EUVペリクル付きマスクの検査工程において、アクティブEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTISシリーズなどと併用することでEUVマスクの全面検査が実現し、生産性のさらなる最適化に貢献します。



*4 ペリクル:露光工程で利用されるフォトマスクの防塵カバー。異物による製造不良を防ぐ

EUV関連検査装置に新製品PELMISが加わり、ラインアップ拡充



Topic

「統合報告書 2024」を発行

当社は、株主さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに対して、レーザーテックの企業活動へのご理解を深めていただくことを目的に、財務および非財務情報を総合的にまとめた統合報告書を2024年に初めて発行しました。経営陣のインタビューや「EUVへの挑戦」と題した特集記事のほか、経営戦略、中期経営計画、サステナビリティ情報などを幅広く掲載しています。ぜひご覧ください。

詳しくはこちら

